



Company Profile



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification





会社概要 (PROFILE)

商 設 資 本 業 務	号 立 金 数 内 容	株式会社 ウイング 1996年10月 1000万円 社員 10名 (2025年3月1日現在) 半導体関連装置の試作開発及び設計・製作
取 引 銀 行		三菱東京UFJ銀行 立川中央支店 武蔵野銀行 久米川支店 西武信用金庫 村山支店 多摩信用金庫 残堀支店



所在地(本社工場)

〒208-0032 東京都武蔵村山市三ツ木1丁目6-1

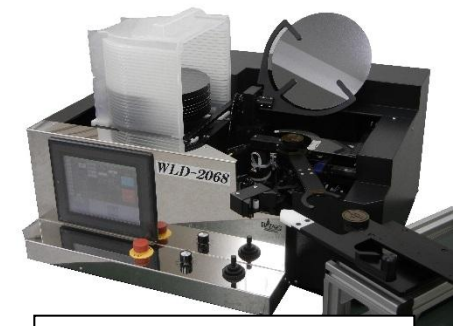
TEL: 042(531)2504 FAX 042(560)0032

URL: <http://www.wing-tdc.com>

E-mailアドレス: m-kondo@wing-tdc.com (近藤)

会社概況 【Company Overview】

年 月	内 容
1996年10月	有限会社 ウイング設立【生産技術的コンサルティングに着手】
1997年 5月	武蔵村山工場を開設し本社を移設 【12in対応セミオートプローバの開発に着手】
2000年10月	株式会社 ウイングに組織変更 【超高精度X-Yステージの開発に着手(リニア仕様)】
2001年 4月	超高精度8in対応電動マニュアルプローバ完成
2002年 5月	上海SEMICON出展
2002年10月	超高精度12in対応セミオートプローバ完成
2002年12月	SEMICON JAPAN出展
2003年 5月	液晶関連大型X-Y装置の開発及び製作開始
2005年12月	『日経 ものづくり』12月号に掲載
2007年 5月	2007年版『中小企業白書』(中小企業庁)に掲載
2008年 4月	新社屋を建設し本社を移設(武蔵村山市三ツ木1丁目)
2011年 6月	ISO9001取得
2011年10月	ウイング初の商品化を実現 【オートローダ WLD-2000シリーズ】
2012年 2月	SEMICON KOREA 2012オートローダ WLD-2000シリーズを出展
2013年 6月	ISO14001取得
2014年 4月	ウエハバーンインシステムに関する特許取得
2015年12月	SEMICON JAPAN 2015 出展
2023年 3月	代表取締役 近藤真季代就任 常務取締役 小原三千代就任 (2023年3月13日付 取締役を決定)



2012年SEMICON KOREA出展



経営方針【Management policy】

企業目的

- ◎私共は、常に最新情報を駆使し、新規装置開発にチャレンジする。
- ◎困難を乗り越え、低コスト、高精度、高品質を実現させ、『ものづくり日本』の伝統を守る事を最大の目的とする。

経営基本方針

- ◎社員一人一人の技術力アップを図り、適正な利潤を確保し、企業の発展を期する。
- ◎豊かな人間性と知性を磨き、健全な生活を送る事により、社会に貢献する。
- ◎広く有能な人材を育成し、企業の永久的な繁栄の礎とする。

品質管理基本方針

- ◎マニュアル化を推進し、データによる管理体制を確立する。
- ◎常に生産方式を見直し、開発装置のコスト低減に努める。
- ◎外注依頼部品、等に関しては、受け入れ検査を徹底し、品質保証に努める。



業務内容【Business contents】

半導体関連装置の開発と製作

次世代半導体関連プロセスにマッチした超高精度装置の開発をはじめ、ユーザーニーズにマッチした、多種・多様な検査装置及び搬送装置の開発を行っております。半導体関連の搬送装置に関しましては、非接触搬送方法、等を独自に開発し、多くのユーザー様に提供しております。

超高精度スライド機構の開発と製作

ナノテクノロジーをリードするウイングのX-Yステージは、多彩な要求に応えるラインナップを用意しております。特徴として、リニア駆動を屈指したステージは、広範囲において、超高精度、低価格、短納期対応が可能です。

12in対応特殊セミオートプローバ

【SAP-300A】



概要

300mmウエハ対応セミオートプローバ
ウエハの投入は、フロントローディング・サイドローディングの2種類に対応
微少電流対応のシールドBOX仕様

対象ワーク

300mmウエハ

外観寸法・重量

寸法 : W1600mm × D1050mm × H1055mm

重量 : 約900kg

ユーティリティ

電源 : 単相AC100V～120V AC200V～240V(50/60Hz) 約0.7kVA
(PC/タッチパネル・ホットチャックは除く)

エア : 0.5～0.6MPa(18L/min) 接続配管径 ϕ 6mm

真空 : -70kPa 接続配管径 ϕ 6mm

ソフトウェア

- ◎ システムデータの編集・管理
- ◎ レシピデータの作成・編集・管理
- ◎ アライメント実行ソフト
- ◎ ガラスマスクキャリブレーション機能
- ◎ ウエハによる位置精度チェック機能



12in対応電動マニュアルプローバ 【MP-300A】



概要

300mmウエハ対応電動マニュアルプローバ

対象ワーク : 300mmウエハ

外観寸法・重量

寸法 : W800mm × D800mm × H470mm (架台除く)

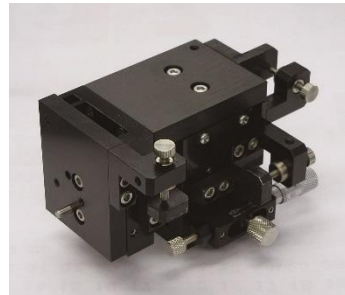
重量 : 約215kg

ユーティリティ

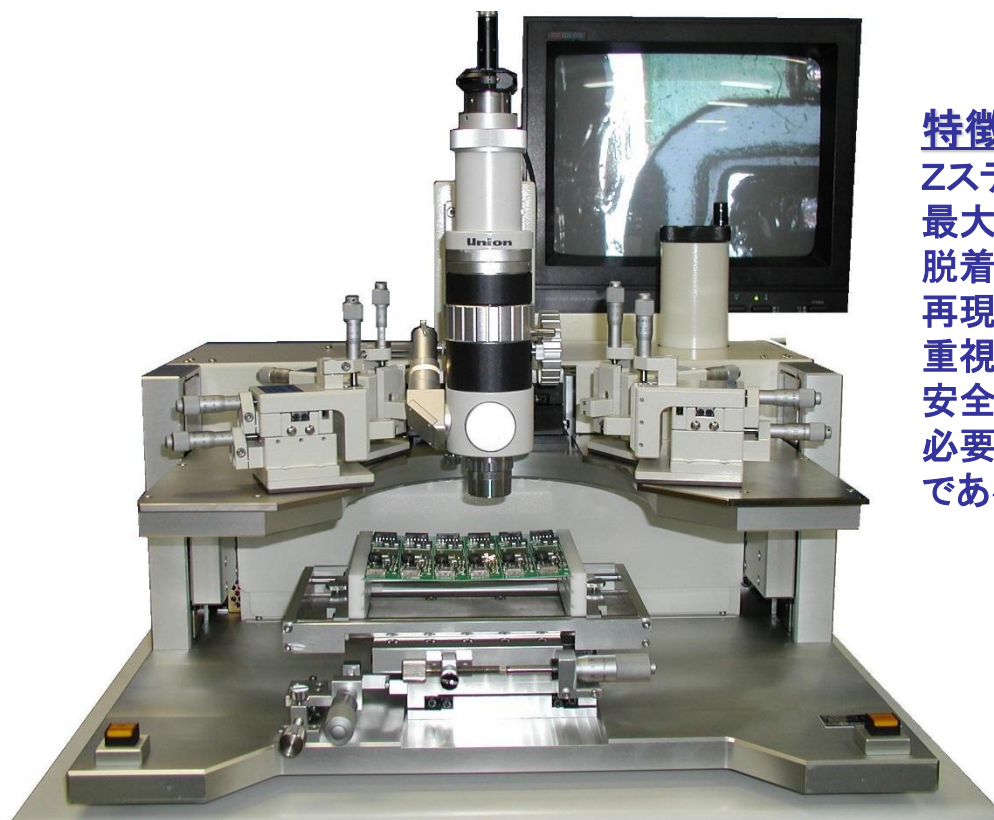
電源 : AC85～264V 50／60Hz 約0.8kVA (ホットチャック除く)

真空 : -70kPa 接続配管径 ϕ 6mm

ドライエア : 0.4MPa 接続配管径 ϕ 6mm



電動マニュアルプローバ 【MP-200B】



特徴

Zステージ及び顕微鏡スタンドの移動を電動にして最大140mm退避させる事が可能であり、ワークの脱着を容易にすると共に、同じ位置へ戻す場合の再現性を考慮した微動位置決め機構を搭載し、作業重視のマニュアルプローバです。

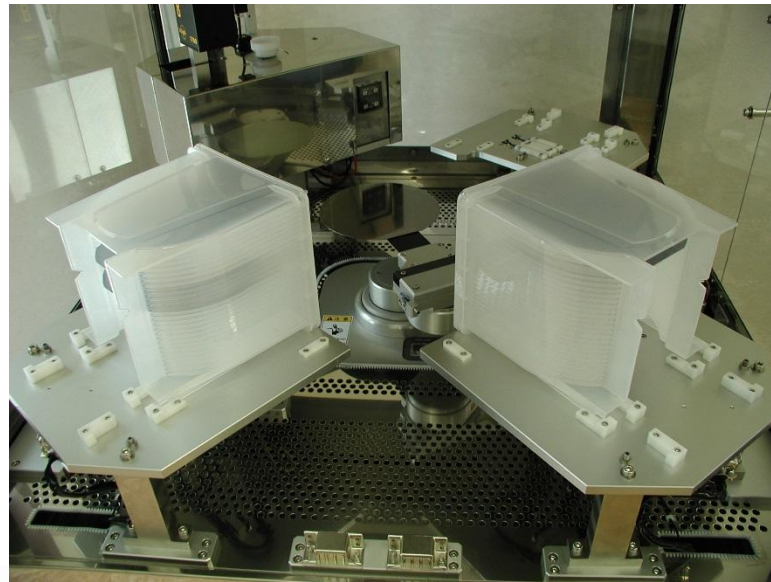
安全面では、Zステージ降下の場合、両手操作が必要であり、作業中の怪我防止を十分考慮したプローバである。



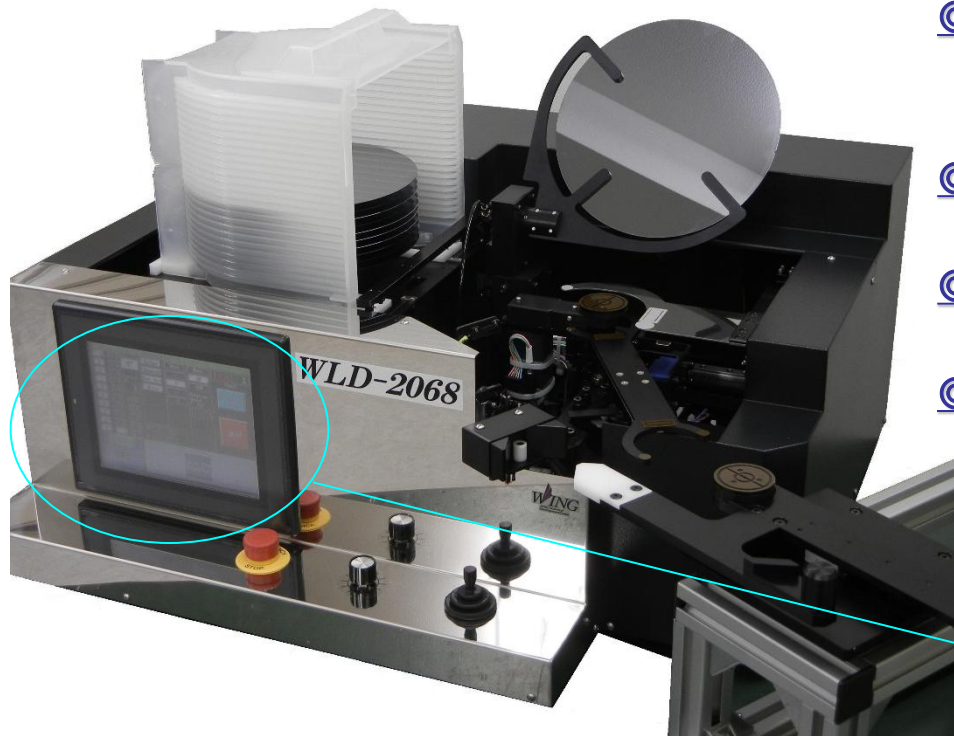
ウェハソータ 【W-ST-200A】

特徴

- ◎8種類までのレシピ登録が可能
- ◎番号に対するスロットの指定が可能
- ◎OCR、アライメントのON/OFFの設定が可能
- ◎クリーンルーム内での使用が可能(カバー等にSUSミガキ材を使用)
- ◎抜き取りカセットを装置した、3カセット仕様である



顕微鏡オートローダ 【WLD-2000シリーズ】



◎概要

3～8インチウエハ用顕微鏡オートローダ
各社顕微鏡に対応

◎対象ワーク(3種類の装置)

3・4インチウエハ、4・6インチウエハ、6・8インチウエハ

◎対象キャリア

3・4・6・8インチウエハ用キャリア

◎外観寸法

W620mm × D550mm × H308mm



ウエハ非接触反転ローダ 【WRL-1500】

◎概要

6インチ極薄ウエハを反転移載するローダ

◎対象ワーク

6インチウエハ : 厚み100 μ m~221 μ m

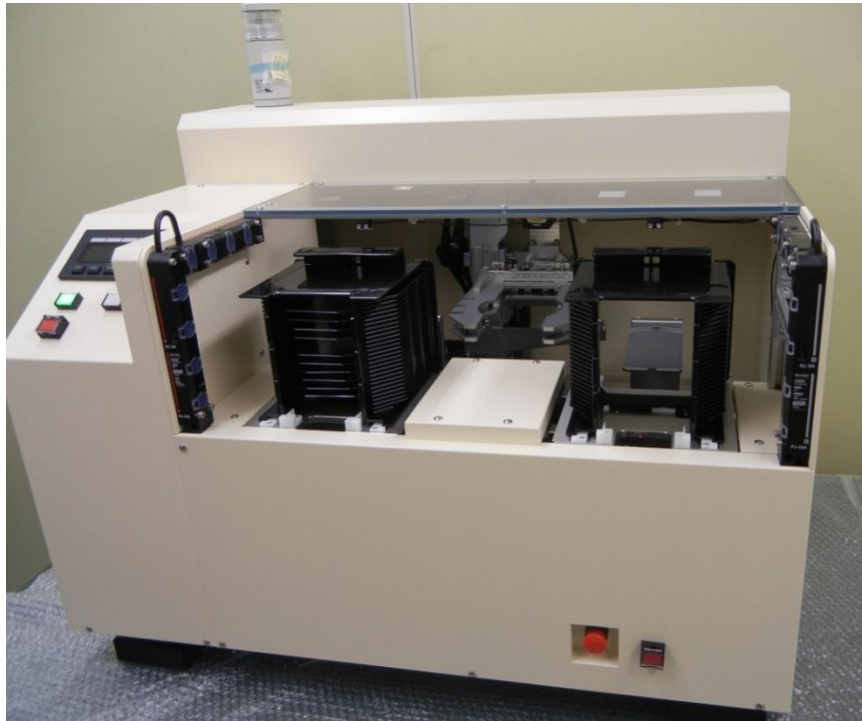
◎対象キャリア

6インチウエハ用キャリア

◎外観寸法・重量

W850mm × D620mm × H605mm

約60kg





EFEM (Equipment Front End Module) 【12in対応】



300mmウエハー用に開発したローディングシステムです。操作性は勿論の事、画像計測、オート測定機、等、様々な装置のドッキングが可能で、BBS (Building Block System) 採用により、用途に応じてオプション選択が可能ですので、予算に合わせた効率的なシステム構成が可能です。また、自社製アライナーを搭載する事により、ソーター機能を付加する事も可能です。



ウエハ移載機【SiC専用】



◎概要

3・4・6インチSiCウエハを6・8インチ治具ウエハに移載する装置

◎対象ワーク

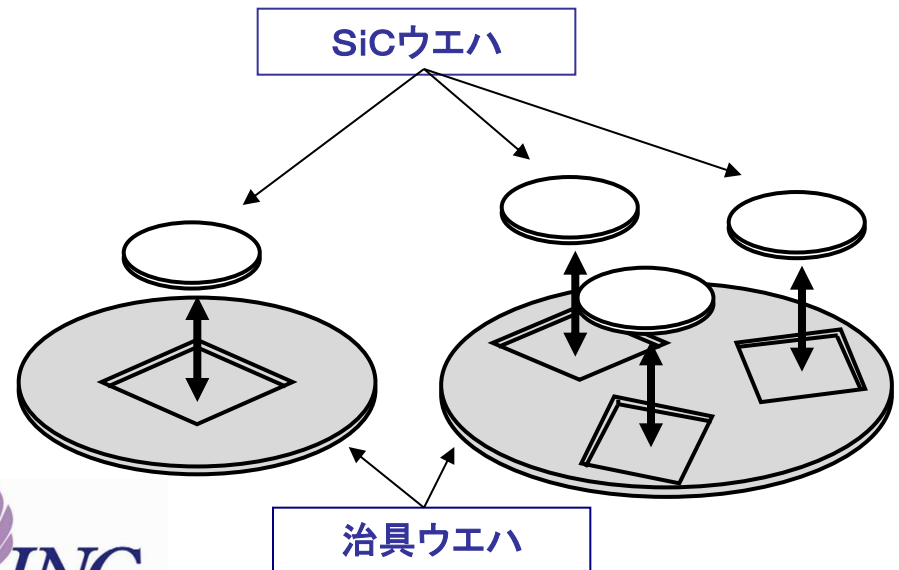
SiC3・4・6インチウエハ、6・8インチ治具ウエハ

◎対象キャリア

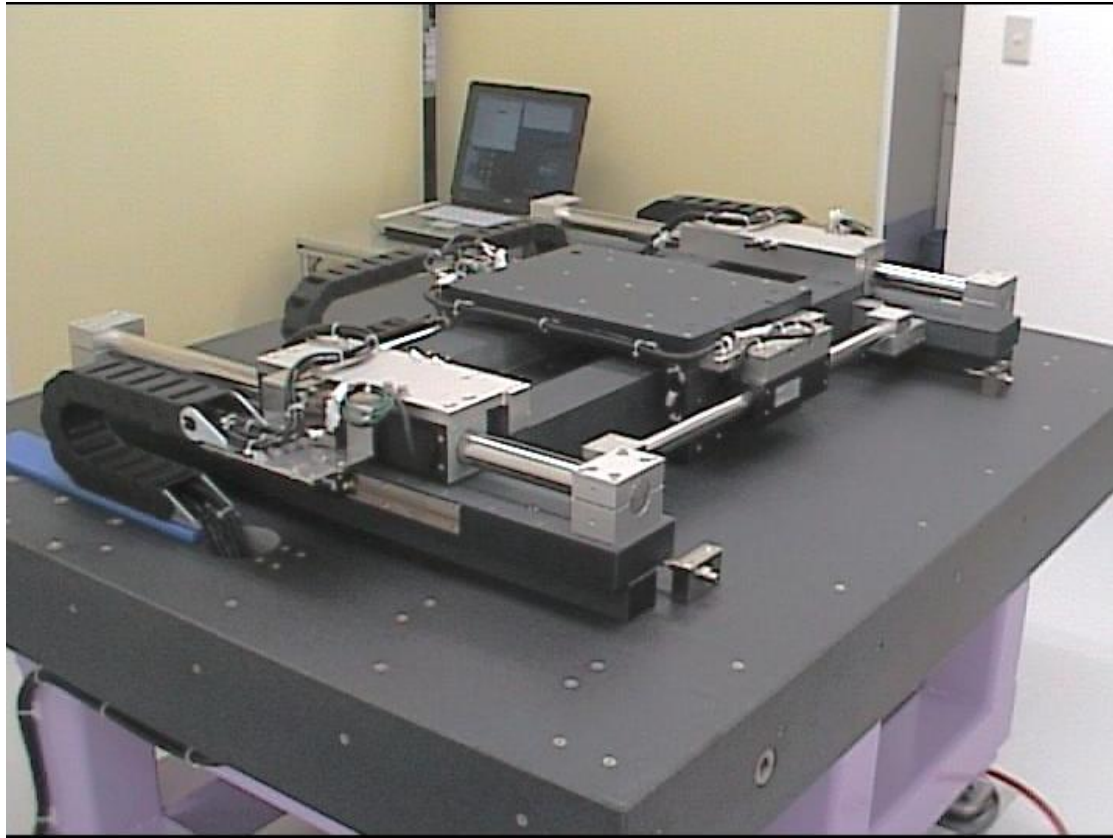
3・4・6・8インチウエハ用キャリア

◎外観寸法

W900mm×D900mm×H1700mm



超高精度エアーステージ【Ultra high precision air stage】



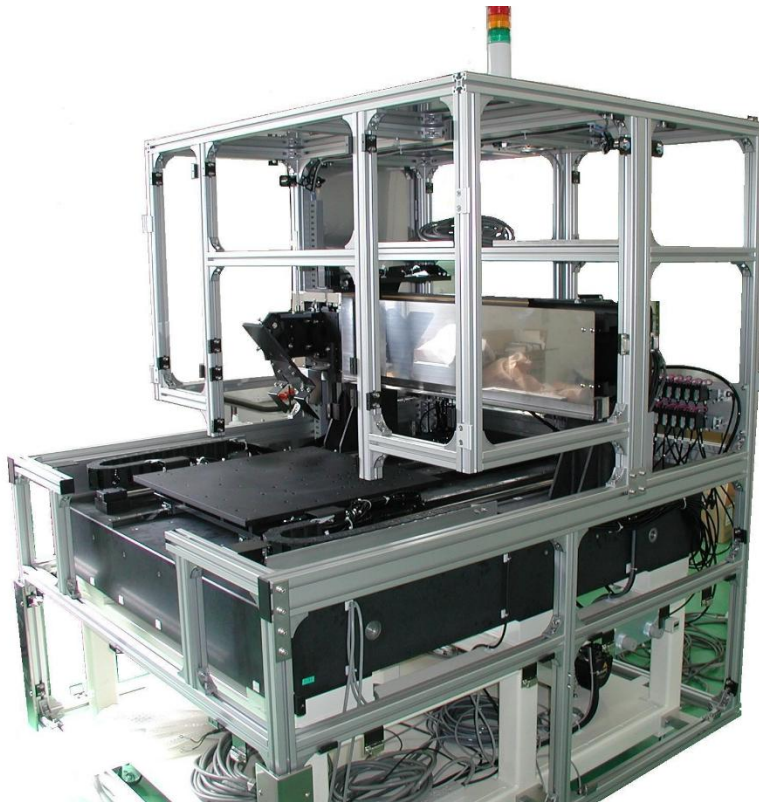
軸名	X軸(上)	Y軸(下)
分解能	0.01 μ m	0.01 μ m
最高スピード	200mm/s	200mm/s
最大加速度	0.05G	0.05G
有効ストローク	340mm	500mm

真直度(垂直)	1.0 μ m	1.0 μ m
真直度(水平)	1.0 μ m	1.0 μ m
姿勢精度(垂直)	2.0秒	2.0秒
姿勢精度(水平)	2.0秒	2.0秒
直角度(X-Y)	2.0 μ m	
繰り返し位置決め精度	0.2 μ m	0.2 μ m
絶対位置決め精度	5.0 μ m	5.0 μ m

ガントリー固定型X-Yステージ

特徴

- ◎等速性1%以下が実現出来、低速での読み取りが可能である。
- ◎石定盤をY軸ステージに使用し、高精度仕様を実現
- ◎X軸にマルチキャリア方式を採用する事により、装置としてのスループットを、アップさせる事が可能である。



項 目	X軸（上軸）	Y軸（下軸）	Z軸
有効ストローク	670mm	800mm	10mm
限界ストローク	700mm	830mm	20mm
速度（MAX）	100mm/sec	300mm/sec	30mm/sec
スケール分解能	1.0μm	0.1μm	
駆動方法	シャフトモータ	シャフトモータ	ボールネジ
姿勢精度【規格値】	30秒／600mm	30秒／700mm	5μm／10mm
等速性	100mm/sec ± 0.5%		
直角度（X-Y方向）	0.005mm	0.005mm	

◎設置スペース

外観寸法(概略) : W1500mm × D1700mm × H2400mm以内

重量 : 約2200kg

◎ワークサイズ : MAX500mm × 400mm (厚さ: 0.02mm ~ 1.0mm)